

ME 12,5 UTG BK - Podstawa obudowy



2201690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201690>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, bez szczeliny wentylacyjnej, szerokość: 12,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: czarny (9005), połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

Korzyści

- Montaż bez użycia narzędzi
- Dostępne w szerokości od 12,5 mm do 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
- Klasa palności V0 wg UL 94
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN
- Opcjonalnie ze zintegrowanym lub montowanym na szynie DIN łącznikiem magistrali

Dane handlowe

Numer artykułu	2201690
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHAAA
Klucz produktu	ACHAAA
GTIN	4046356893299
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	39,16 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	39,16 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

ME 12,5 UTG BK - Podstawa obudowy



2201690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201690>

Dane techniczne

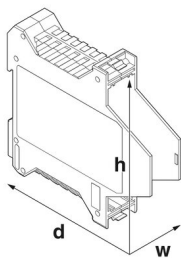
Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	Podstawa obud. bez szczel. wentyl., wymagana do skompletowania modułu pokrywy obudowy
Typ produktu	Podstawa obudowy
Rodzina produktów	ME...UTG
Wykonanie	Podstawa obudowy z nóżką metalową, wysoka konstrukcja
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	ME

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	12,6 mm
Wysokość	99 mm
Głębokość	107,3 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	100,7 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN do punktu oparcia części górnej	68,5 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	czarny (9005)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 20 °C

ME 12,5 UTG BK - Podstawa obudowy



2201690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201690>

Temperatura otoczenia	20 °C
Współczynnik redukcji	1
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	4,3 W

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 30 °C

Temperatura otoczenia	30 °C
Współczynnik redukcji	0,91
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	3,9 W

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 40 °C

Temperatura otoczenia	40 °C
Współczynnik redukcji	0,81
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	3,5 W

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 50 °C

Temperatura otoczenia	50 °C
Współczynnik redukcji	0,7
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	3 W

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 60 °C

Temperatura otoczenia	60 °C
Współczynnik redukcji	0,57
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	2,4 W

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 70 °C

Temperatura otoczenia	70 °C
Współczynnik redukcji	0,49
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	2,1 W

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzoną drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C

ME 12,5 UTG BK - Podstawa obudowy



2201690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201690>

Czas działania	30 s
----------------	------

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20 N

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	10

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj udaru	Półsinusioda
Przyspieszenie	15g
Czas trwania udaru	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------------	-----------------------------------

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	1
Sposób mocowania PCB	Moduł wsuwany (opcjonalny zatrzask przez blokadę wyciągnięcia PCB)
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

ME 12,5 UTG BK - Podstawa obudowy

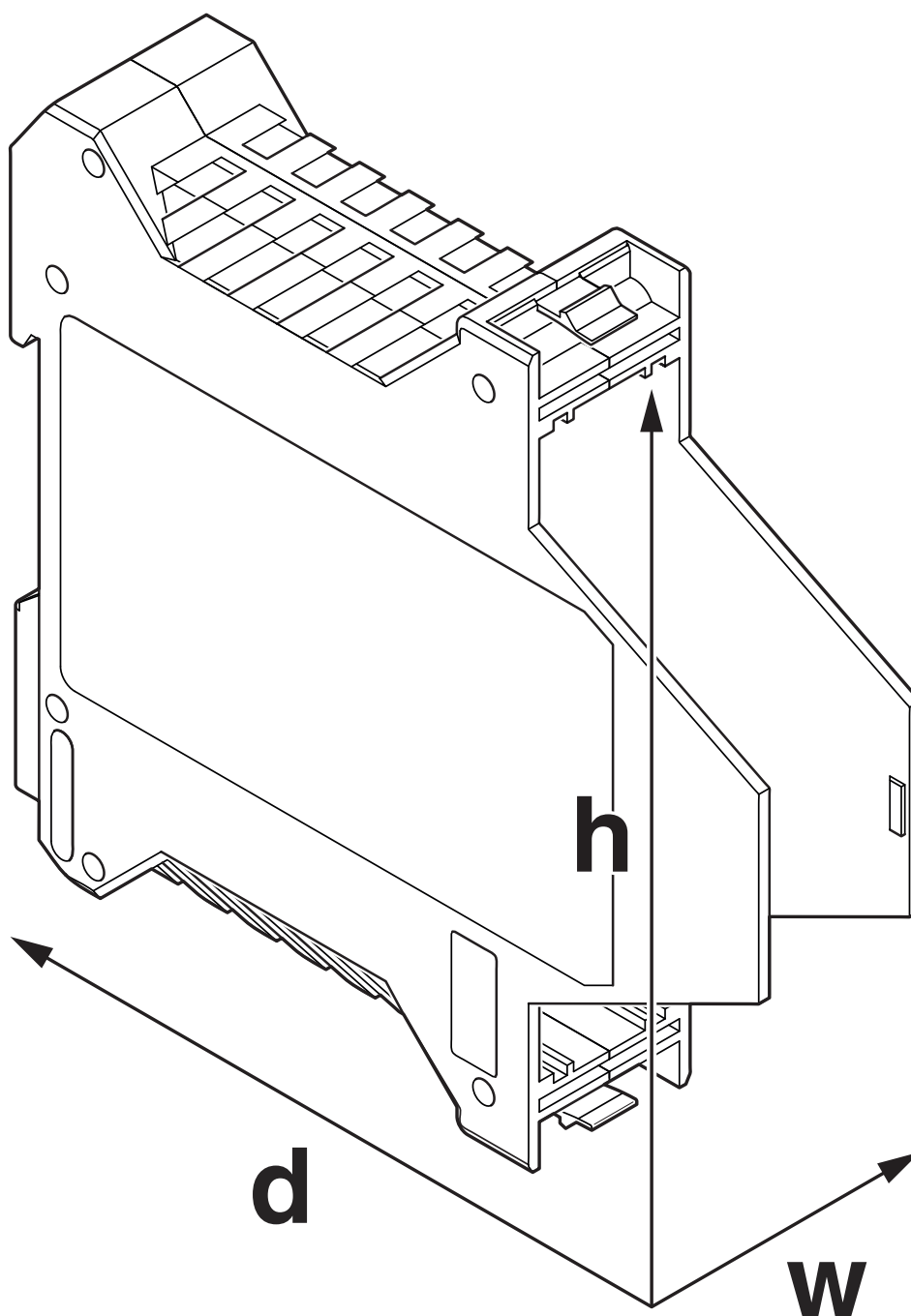
2201690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201690>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ME 12,5 UTG BK - Podstawa obudowy

2201690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201690>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201690>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

ME 12,5 UTG BK - Podstawa obudowy

2201690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201690>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME 12,5 UTG BK - Podstawa obudowy

2201690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201690>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

ME 12,5 UTG BK - Podstawa obudowy

2201690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201690>



Konieczne akcesoria

ME 12,5 OT-MSTBO SET BK - Góra obudowy

2706360

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706360>

Obudowa na szynę DIN, Zestaw składający się z góry obudowy, 4 szt. gniazd do PCB (2-pinowe) i 4 szt. terminali przyłączeniowych do PCB z przyłączem śrubowym (2-pinowe), szerokość: 12,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 45,85 mm, kolor: czarny (9005)



Akcesoria

ME LPZS - Blokada wyciągnięcia PCB

2906911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906911>

Obudowa na szynę DIN, blokada wyciągnięcia PCB ME LPZS zapobiega po ok. 4 cm całkowitemu wyciągnięciu płytki, unieruchamiając ją jednocześnie



ME 12,5 UTG BK - Podstawa obudowy

2201690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201690>



EML (44X76)R-ME - Etykieta dla obudowy ME ... UT

0828130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828130>



Etykieta dla obudowy ME ... UT, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: bez nadruku, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 44 x 76 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 200

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl